

## Lenovo EPYC AMD 7313 processeur 3 GHz 128 Mo L3

Marque : Lenovo

Famille de produit: EPYC

Code produit: 4XG7A63607

Nom du produit : AMD EPYC  
7313



16 cœurs, 32 threads, 3GHz fréquence de base, 3.7GHz fréquence Boost maximale, 128MB L3 cache, 155W TDP

[Lenovo EPYC AMD 7313 processeur 3 GHz 128 Mo L3:](#)

### AMD Infinity Guard

AMD Infinity Guard aide à minimiser les surfaces d'attaque potentielles lorsque le logiciel est démarré, exécuté et accède à vos données critiques

### Architecture AMD Infinity

Grâce à notre statut de leader dans le domaine de l'architecture, des performances et de la sécurité, notre démarche de conception de processeurs accélère la marche de l'innovation afin de mettre un terme à des années de stagnation dans le domaine des centres de données

Lenovo EPYC AMD 7313. Famille de processeur: AMD EPYC, Socket de processeur (réceptable de processeur): Socket SP3, Fabricant de processeur: AMD. Canaux de mémoire: Octa-canal, Types de mémoires pris en charge par le processeur: DDR4-SDRAM, Vitesses d'horloge de mémoire prises en charge par le processeur: 3200 MHz. Segment de marché: Serveur

Processeur		Processeur	
Fabricant de processeur *	AMD	TDP configurable vers le bas	155 W
Modèle de processeur *	7313	<b>Mémoire</b>	
Fréquence de base du processeur *	3 GHz	Types de mémoires pris en charge par le processeur	DDR4-SDRAM
Famille de processeur *	AMD EPYC	Vitesses d'horloge de mémoire prises en charge par le processeur	3200 MHz
Nombre de coeurs de processeurs *	16	Canaux de mémoire *	Octa-canal
Socket de processeur (réceptable de processeur) *	Socket SP3	Bande passante mémoire (max)	204,8 Go/s
composant pour	Serveur/Station de travail	<b>Graphique</b>	
Nombre de threads du processeur	32	Carte graphique intégrée *	✗
Fréquence du processeur Turbo	3,7 GHz	Adaptateur de carte graphique distinct *	✗
Mémoire cache du processeur	128 Mo	Modèle d'adaptateur graphique inclus *	Indisponible
Type de cache de processeur	L3	Modèle d'adaptateur graphique distinct *	Indisponible
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power)	155 W	<b>Caractéristiques</b>	
Boîte *	✗	Segment de marché	Serveur
Enveloppe thermique élevée configurable	180 W	Nombre maximum de voies PCI Express	128
Refroidisseur inclus *	✗	Version des emplacements PCI Express	4.0



0889488572540



889488572540

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.